

Title (en)

Device for the admission of ceramic heating elements and procedure for the production of such

Title (de)

Vorrichtung zur Aufnahme von Keramik-Heizelementen und Verfahren zur Herstellung einer solchen

Title (fr)

Dispositif pour l'admission des éléments de chauffe en céramique et procédé pour la production de tels

Publication

EP 1467599 A2 20041013 (DE)

Application

EP 04008392 A 20040407

Priority

- DE 10333451 A 20030722
- DE 20305936 U 20030412

Abstract (en)

The device has an insulating frame (1) and at least one contact plate (2) held by the frame and on which the heating elements can be placed. The contact plate is held in the frame in a force-locking manner. The contact plate is completely covered by the frame at least in a limited section of its length. The plate is held in grooves in longitudinal frame struts (1.1) over most of its length. An independent claim is also included for the following: a heating device and a heating element.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufnahme von Keramik-Heizelementen (PTC-Elementen, Kaltleitern) in einer Heizvorrichtung, mit einem isolierenden Rahmen und mindestens einer durch diesen gehaltenen Kontaktplatte, auf der die Heizelemente auflegbar sind. Die erfindungsgemäße Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontaktplatte kraftschlüssig im Rahmen gehalten ist. Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass zumindest auf eine einer Aufnahmeseite für die Heizelemente abgewandten Seite einer Kontaktplatte eine Schicht aus folgenden Materialien aufgespritzt oder aufgesprüht wird: Kunststoff, Polymerkeramik, Keramik <IMAGE>

IPC 1-7

H05B 3/26

IPC 8 full level

H05B 3/06 (2006.01); **H05B 3/14** (2006.01); **H05B 3/50** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

E02B 7/28 (2013.01 - KR); **E02B 7/36** (2013.01 - KR); **H05B 3/06** (2013.01 - EP US); **H05B 3/141** (2013.01 - EP US); **H05B 3/50** (2013.01 - EP US); **E05Y 2201/216** (2013.01 - KR); **E05Y 2201/46** (2013.01 - KR); **E05Y 2600/10** (2013.01 - KR); **E05Y 2600/314** (2013.01 - KR); **E05Y 2900/40** (2013.01 - KR); **H05B 2203/02** (2013.01 - EP US)

Cited by

FR3020125A1; CN103629805A; DE102012107600B4; US7667166B2; EP2109345A1; DE102012107113A1; US9265093B2; EP1916874A2; DE102012107600A1; US9435562B2; EP2607808A1; DE102012107985A1; US9486871B2; DE102012107985B4

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1467599 A2 20041013; **EP 1467599 A3 20060405**; **EP 1467599 B1 20081126**; KR 20040089570 A 20041021; US 2004200829 A1 20041014; US 2006138712 A1 20060629; US 7816630 B2 20101019; US 7977610 B2 20110712

DOCDB simple family (application)

EP 04008392 A 20040407; KR 20040025134 A 20040412; US 33439806 A 20060119; US 82186304 A 20040412